



NEW TECHNOLOGY OVERMAN

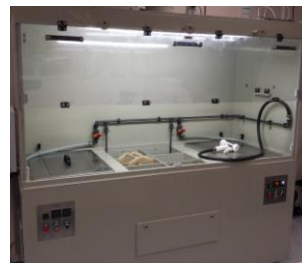


HEIßLUFTVERZINNUNGSANLAGE

Erhältlich Typen:: 18"x18" bis zu30"x30"
SPS gesteuerte oder elektrisch gesteuerte Ausführung
Für Blei Zinn oder Bleifreie Anwendung.

HCL ANLAGEN / SPEZIALPRODUKTE

Polypropylen-Linien oder Anwendungen:
Spülen / Trocknen, Vor- und Nachreinigung, Fluxgeräte,
Dosiereinheiten, Misch- und Puffertanks, Kundenspezifisch,
Prototyp und Spezial
Anwendungen.



VERTIKALE PLATING LINIEN (VPL)

Automatische Leiterplattenanlagen
für die Oberflächenbehandlungs-
verfahren für Kupfer Leiterplatten-
aufbau, ENIG, ENIGIG Linien usw.
Oberflächenbehandlungslinien für
Forschung, Entwicklung und
manuelle Fertigung.

New Technology Overman hat sich spezialisiert auf Design, Entwicklung, Herstellung und liefern von komplette Hot Air Solder Levellers , HASL Prozesslinien , galvanotechnischen Anlagenbau von Leiterplattenanlagen in Gestell- oder Korbtechnik für die Oberflächenbehandlungsverfahren in der gedruckten Leiterplatten Industrie.